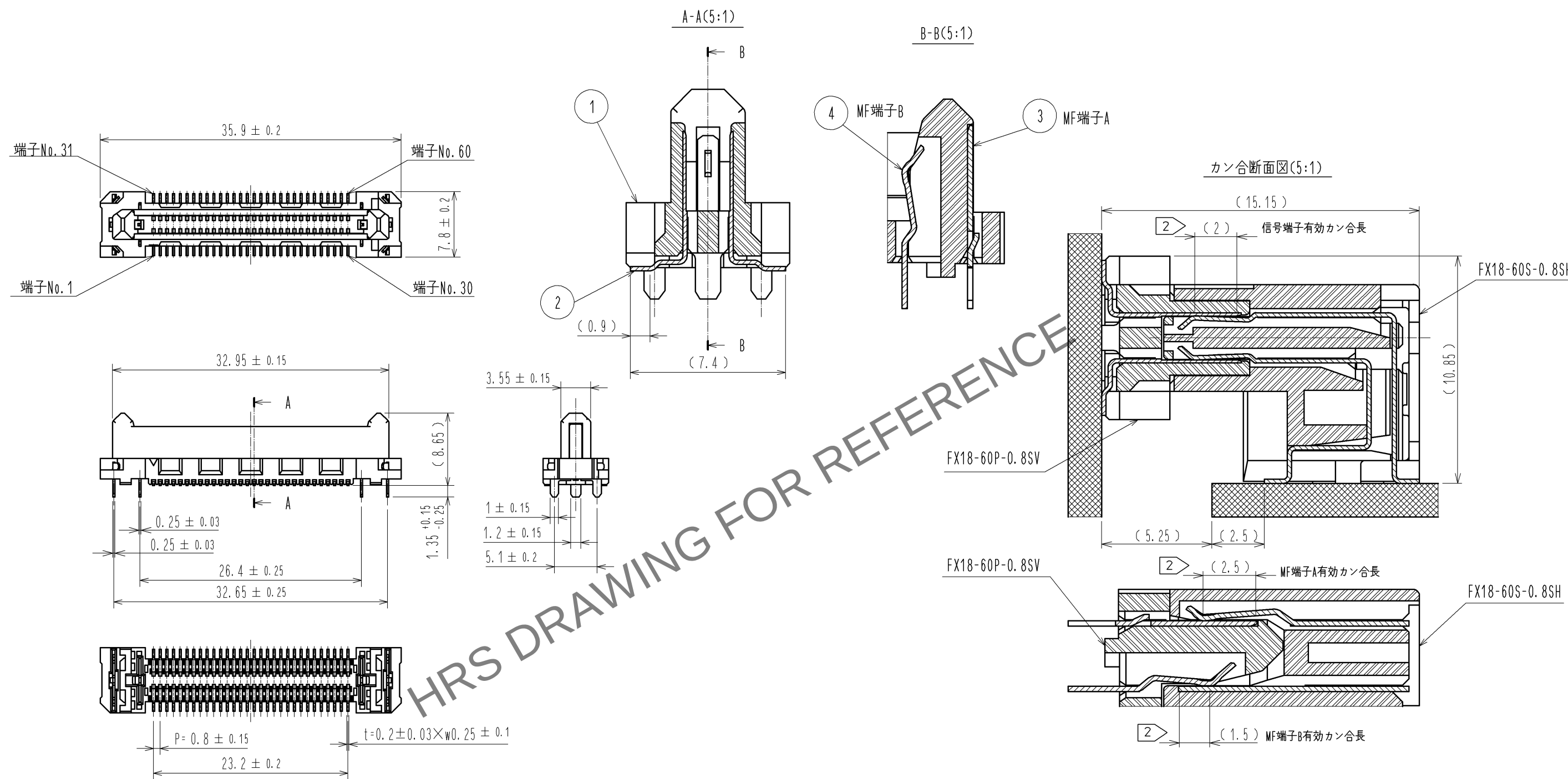




- 注 1 本製品のSMTリート・部の平坦度は0.1以下となります。
- 2 本製品はMF端子A⇒信号端子⇒MF端子Bの順に接触するシーケンス構造となっております。
シーケンス機能を利用する場合はその機能を損なわない為に斜めカン合は避けて下さい。
- 3 MF端子A及びMF端子Bを電源用として使用することも可能です。
この場合は3A/ヒ・ン以下でご使用下さい。
- 4 本製品の吸着スぺ・ース（吸着テーフ・位置）を示します。（2へ・ーシ・目参照）
吸着テーフ・はコネクタをカン合する前に必ず取り外して下さい。
- 5 本製品の納入形態はエンホ・ス梱包（1RL=400個）となります。
- 6 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
- 7 ()内寸法は参考値を示します。
- 1 8 MF端子Aの実装部は2箇所に分かれておりますので異なる回路ハ・ターンを接続しない様ご注意願います。

3	りん青銅	接触部：金めっき0.1μm	7	ポリイミド	(吸着テープ)		
		実装部：すずめっき1μm					
		下地：ニッケルめっき1.3μm					
2	りん青銅	接触部：金めっき0.1μm	5	ポリエステル	(エンボスカバーテープ)		
		実装部：金めっき0.03μm					
		下地：ニッケルめっき1.3μm					
1	ポリリアミット樹脂	クロ U L 94 V - 0	4	りん青銅	接触部：金めっき0.1μm		
部番	材 質	処 理 , 備 考			部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数 4	訂 正 記 事 DIS-F-005578	設 計 TH. SANO	検 図 KI. HIROKAWA	年月日 11. 07. 21
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : HS. OKAWA	10. 05. 10	図番:	ADC3-159561-02			
		検 図 : KI. HIROKAWA	10. 05. 10	製品名:	FX18-60P-0.8SV(11)			
		設 計 : TH. SANO	10. 05. 10	製品コード	CL579-0017-2-11			
		製 図 : KI. HIROKAWA	10. 03. 04					1/2

